

計 画 書

1	会誌掲載の際の希望見出し	参加募集
2	行事名	The 13 th International Symposium on Sputtering and Plasma Processes (ISSP 2015)
3	主 催	一般社団法人 日本真空学会 AVS
4	協 賛	公益社団法人 日本セラミックス協会、 公益社団法人 応用物理学会ほか
5	日 時 (年表記は西暦)	2015年7月8～10日(水～金曜) 9:00～19:00 初日は10:00～, 最終日～16:40まで
6	場 所	(会場名) 京都リサーチパーク (KRP) (住 所) 京都市下京区中堂寺南町134
7	行事の内容	スパッタリングおよびプラズマプロセス技術を主題とした国際会議
8	参加費	協賛学会会員は 2015年6月5日(金)までの申し込み 52,000円 (期日以降 57,000円)
9	申込締切	アブストラクトの締め切り 2015年1月19日(月)
10	申込・連絡先	所在地: 〒924-0838 石川県白山市八束穂3-1 所属機関名・部署名 金沢工業大学・高度材料科学研究開発センター内 ISSP2015事務局 担当 堀 則子 TEL: 076-274-9250 FAX: 076-274-9251 E-mail: sec@issp2015.org
11	URL	http:// issp2015.org (10月頃 掲載予定)